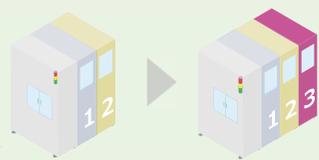


成長する設備

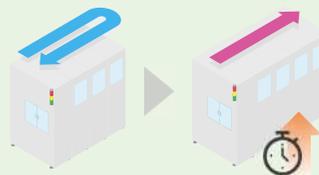
お客様のニーズに合わせて変化する装置 “S-FORM”
開発、研究装置から量産装置へ

高機能化



薬液モジュール追加 ⇒ プロセス拡充

生産効率UP



U/LDモジュール追加 ⇒ リターン式からワンウェイ式へ

人件費削減



バッファー・EFEM追加 ⇒ FA対応可能

装置停止を極限まで短縮

従来装置
約21日



S-FORM
1日

増設は、モジュール単体で立上。ドッキング時のみ装置停止。
生産への影響の抑制に貢献

※当社比

STEP1
初期投資



STEP2
増産投資



STEP3
FA化投資



S-FORMについて
<https://wp.toho-kasei.co.jp/product/s-form/>

その他製品情報について
<https://wp.toho-kasei.co.jp/product/>



“必要!”に応えるモジュール式

モジュール
10種類以上
目的に合わせた選択と
組合せが可能。

高い拡張性
生産量やプロセスの変
更にも、柔軟に対応し
ます。

モジュールサイズ

幅 0.6m
奥行 1.5m
高さ 2.3m



プロセスモジュールバリエーション

ウェットモジュール

APM, SPM, HPM, HF, PRS, FR

ドライモジュール

TMD II, S/D, V/D,

各薬液モジュールには
リンス槽が付属します

狭幅小型で環境にもやさしい

省スペース化

約 **50%**

SPM
10.5㎡ ▶ 5.4㎡

薬液使用量

57%抑制

ハーフピッチ
52.5ℓ ▶ 22.5ℓ

排気量

61%抑制

36㎡/min
▶ 14㎡/min

スペース生産性：23.3枚/㎡

カセット搬送タイプ
(弊社従来品より85%向上)

※ 当社従来品比

ヒトにもモノにも安心

FAに対応

対応方式：
SMIF/カセット
OHT/AGV

安全性

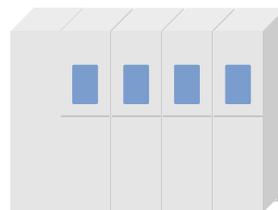
ISO-13849-1
カテゴリ-4 に準拠

短リードタイム

部品の在庫を確保し、よ
り早い納期で対応します。

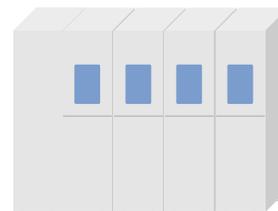
プロセス例

<Clean>



LD U/LD TMD SPM HPM APM

<Resist Remover>



LD U/LD S/D IPA NMP NMP

<Oxide Etch>



LD U/LD S/D HF BHF BHF

ここに挙げたプロセス以外にも
対応しております



S-FORM
製品ページ



対応ウェーハサイズ

6インチ・8インチ

スループット

133wph

10分処理・50枚ハーフピッチ時

パーティクル量

0.3μm ≤ 10個 / 0.2μm ≤ 30個

